

# 국내 공급가능 자동화기기에 관한 관세감면 품목에서의 조정 건의

※ 편집자 주 : 본고는 공장자동화·정보화 추진 협의회에서 국산공급이 가능한 품목에 대하여 관세감면을 하는 사례가 있어 국산화 추진업계의 의욕저하, 외국산 도입으로 인한 사후관리 등의 어려움으로 국산 사용을 적극 권장하는 측면에서 아래품목을 관세감면 대상품목에서 재 조정하여 주기를 상공부에 건의한 내용임을 밝힌다.('91.7.20)

회사명	연번	HS세번 (10단위)	품명	규격	자동화유형	신청업체 (기관)	비고
선경 메그네틱	1	8479-89-9040	조립기 (Assembly Machine)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1 수치제어 방식의 것 2 PLC 방식의 것으로서 자동측정(검사)·장치, 부착형의 것	2가	선경메그네틱 (주)	규격추가
대우 캐리어	2	9031-80-9000	공안 검사기 (Air Leak Tester)	PLC 또는 컴퓨터 방식의 것으로 가전제품 또는 자동차 부품의 Leak 유무 측정용의 것에 한함	2가	대우캐리어	가전제품용
	3	9027-10-0000 9031-80-9000	가스누출, 진공누출 또는 누수 탐지기 (He Leak Detector, He Leak Tester)	PLC 또는 컴퓨터 방식의 것으로서 가전제품 또는 유공압기기의 Leak 유무 측정을 위해 헬륨(He)을 이용한 것에 한함	2가		
대우전자	4	9030-39-9000	압축기 자동검사기 (Auto Tester For Compressor)	내전압, 절연시험, 승압시험 역류량 시험이 가능할 것	2가	대우전자(주)	
	5	8479-89-9000	반자동 부품 삽입기 (Semi Auto Insertion M/C)	자동삽입이 곤란한 부품의 삽입이 가능할 것 Control용 PC가 내장되어 있는 것	1-나	대우전자(주)	
	6	8477-59-0000	저압 발포기 (Mini Dosing M/C)	경화제와 Polyol의 혼합비가 1:100-100:1일 것 Micro Processor가 내장되어 있는 것	2가	대우전자(주)	
	7	8479-89-9000	Coil 성형기	Coil의 Forming, Lacing, Knotting의 일련의 작업을 연속적으로 수행할 것	2가	대우전자(주)	추 가
	8	8479-89-9000	틀니내는 기계 (Hobbing Machine)	NC Control이 가능한 것	2가	대우전자(주)	
삼성전자 (가전)	9	8414-80-9220	기체압축기 (Air Compressor)	트브형(Centrifugal Type)으로서 사용동력이 280KW 이상의 것	2가	삼성전자(주) 가전부문	

회사명	연번	HS세번 (10단위)	품명	규격	자동화유형	신청업체 (기관)	비고
	10	8423-90-0000 8479-89-9099	자동 이송장치 (Auto Transfer M/C)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 자동로딩, 언로딩 기능을 가진 것으로서 제품 또는 부품을 이송하는 것으로 이송거리 10M 이상의 것 2. 수치제어방식, PLC 또는 컴퓨터방식의 것으로서 자동제어 기능을 가진 것에 한함	1-나	삼성전자(주) 가전부문	
	11	8423-90-0000 8479-89-9099	자동 로더장치 (Auto Loader/Unloader)	PLC 수치제어방식 또는 컴퓨터 제어방식의 것으로서 부품 또는 가공물을 주기계(가공기계)로 자동공급 및 자동배출이 가능한 것에 한함	1-나	삼성전자(주) 가전부문	
	12	8456-30-0000	방전가공기 (Electrical Discharging Machine)	수치제어 방전가공기로서 테이블의 크기가 600×500 이상이고 위치변차가 5um 이하의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	13	8457-10-0000	머시닝 센터 (Machining Center)	수치제어방식의 것으로서 스트로크가 1,000 × 750mm 이상이고 반복정밀도가 +3um 이하의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	14	8458-11-0000 8458-91-0000	선반 (Special Lathe)	수치제어방식의 것으로서 가공 최소 설정치가 1um 이하의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	15	8479-89-9099	디스크복제장치 (Monoliner MK)	광디스크 제조용으로서 증착, 도포, 인쇄기능을 갖춘 것으로 증착두께가 10um 이하의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	16	8462-21-0000 8462-29-0000 8479-89-9099	확관기 (Tube Expander M/C)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 수치제어방식의 것으로서 확관추력이 20Ton 이상의 것 2. 공조기기 열교환기 제작용으로서 최대 확관 본수가 80본 이상의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	17	8462-21-0000 8462-29-0000 8479-89-9099	축관기 (Pipe End Forming M/C)	시퀀서 제어방식의 것으로서 자동공급 및 배출장치가 부착된 것에 한함	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	18	8462-91-0000 8462-99-0000 8479-89-9010	프레스 (Press)	공조기기의 열교환기용 Fin을 타발하는 프레스로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 가공물을 자동공급하는 Uncoler와 저장하는 Stacker부가 부착되어 자동타발이 가능한 것 2. 가압력이 45Ton 이상이며 스트로크가 45mm 이상의 것 컴퓨터 제어방식의 Terret Punch Press 가공 편심도가 70um 이하의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	19	8479-89-9099	증착기 (Sputtering M/C)	PLC, 수치제어식 또는 컴퓨터 제어방식의 것으로서 증착두께가 10um 이하까지 증착이 가능한 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	20	8479-89-9099	열전사기 (Hot Stamping M/C)	수치제어방식의 것으로서 알루미늄 Stamping 전용의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	21	8459-31-0000	밀링 보링기 (Milling & Boring M/C)	수치제어방식의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 위치정밀도가 3um 이하의 것 2. 수직 또는 수평의 속도범위가 최대 3 000 RPM 이상의 것 3. 수직스트로크(Vertical Quill Stroke)가 80mm 이상의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	22	8477-10-2000	사출 성형기 (Injection Moulding M/C)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 수치제어방식의 것으로서 1회 사출용량이 32cm 이하의 것 2. 2색 사출 성형기에 한함	2-가	삼성전자(주) 가전부문	

회사명	연번	IIS세번 (10단위)	품명	규격	자동화유형	신청업체 (기관)	비고
				3 Closed Loop Injection 방식의 것			
	23	8479-81-3000	자동권선기 (Automatic Coil Winding Machine)	마이크로프로세서에 의한 제어방식으로서의 코일 권선수가 최대 900 Turn 이상의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	24	8479-89-9099	우레탄 자동주입기 (Urethane Injection M/C)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 마이크로프로세서에 의한 제어방식의 것 2. 토출량의 타이더 제어가 +3% 이하의 정밀도를 가진 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	25	8479-89-9099	진공 배기장치 (Vacuum Exhausting Equipment)	마그네트론 제조용의 것으로서 진공도가 10Torr 이하의 것에 한함	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	26	8479-89-9099	도포기 (Auto Solder Dispenser & Screen Printing M/C, ETC)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 스크린프린팅 방식에 의한 납도포방식의 것으로서 스크린틀 조정폭이 10mm이내의 것 2. 디스펜서 방식의 납도포기로서 인쇄회로 기판에 접착제(Gule)를 도포하는 것 3. Spin Coater 방식의 것 4. 보호피막 도포기로서 0.5mm 이하의 도포막을 형성시킬 수 있는 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	27	8479-89-9099	압압기 (Auto Staking M/C)	PLC 또는 수치제어 방식의 것으로서 부품을 압압하는 것에 한함	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	28	8479-89-9099	인쇄회로기판 조립기 (PCB Assembly System)	In-Line 방식으로 자동로딩, 인로딩장치, 인쇄회로기판에 납도포, 부품장착, 경화기능을 가진 단위기기가 System화 되어 있는 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	29	8424-30-9000 8479-81-1000	세척기 (Aqueous Cleaning M/C)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. PCB 세척용의 것으로서 Recirculating 2 Stage 제어방식의 것 2. PLC, 수치제어식 또는 컴퓨터 제어방식으로서 연속식, 인덱스식 또는 자동식의 것 3. 순수 또는 화공약품을 사용하는 것 4. 초음파를 이용하는 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	30	8480-71-0000 8480-79-0000	금형 (Mould)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 오차한도의 0.001 inch 이하의 것 2. 표면조도가 0.006S 이상의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	31	8515-19-0000 8514-20-9000	자동납땀기 (Auto Soldering M/C)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 기관이동과 Flux의 비중 콘트롤이 자동으로 되는 것 2. Surface Mounting Component (표면실장부품) 전용의 것 3. Reflow 또는 Brazing 방식의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	32	9027-80-2020	열량계 및 열량분석기 (Calorimeter)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 재현성 측정 정도가 +1% 이하의 것 2. 냉·난방식 열부하가 최대 20,000Kcal/Hr 이상의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	34	9030-39-9000 9030-40-9000 9030-81-0000 9030-89-0000	전자파 측정기 (EMC-EMI-EMS Testing System)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 100Khz 이상의 전자기 간섭주파수를 측정할 수 있는 것 2. 제품의 전원 잡음(Noise) 성분과 정전기 성분을 Simulation이 가능한 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	35	9030-39-9000 9030-80-0000	마이크로프로세서 개발 시스템 (Micropro-	마이크로프로세서의 Logic, Static, Timing Software Performance 분석이 가능한	2-가	삼성전자(주) 가전부문	

회사명	연번	HS세번 (10단위)	품명	규격	자동화유형	신청업체 (기관)	비고
		9000-80-0000	essor Development System)	것에 한함			
	36	9000-30-0000 9000-81-0000 9000-80-0000 9000-40-0000 9001-80-0000	측정용 컴퓨터 (Computer Aided Tester)	컴퓨터를 이용한 측정장치로서 C.A.T (Computer Aided Testing)에 한함	1-나	삼성전자(주) 가전부문	
	37	9000 9001	시뮬레이터 (Simulator)	컴퓨터를 이용한 시뮬레이션 해석장치(C.A.E : Computer Aided Engineering) 장치에 한함	1-나	삼성전자(주) 가전부문	
	38	9001-80-0000	진동 시험기 (Vibration Testing M/C)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 사인(Sine) 또는 랜덤(Random) 시험이 가능하며 측정범위가 30Mhz 이내의 것 2. 컴퓨터와 연동이 가능한 것으로서 최대 측정물 중량이 1,000Kg 이상의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	39	9001-80-0000	리드라인 측정기 (Head Drum Lead Line Measurement System)	측정범위가 반경 50mm 이내의 것으로서 회전정도가 0.5um이하이고, 테이블의 회전속도가 2Rpm 이상의 것에 한함	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	40	9001-80-0000	3차원 측정기 (3-Axis Coordinate Measurement System)	컴퓨터제어방식의 것으로 최소표시량이 1um 이하의 것에 한함	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	41	9001-40-0000 9001-81-0000	드럼헤드 조정기 (Drum Head Adjustment Equipment)	VTR 또는 DAT 헤드의 돌출, 자세, 높이 등을 측정하는 기기로서 장치재현성의 높이가 1um 이내의 것에 한함	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	42	8460 8464-20-2000	연마기(플리싱기포함) Auto Grinding M/C Auto Polishing M/C	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 수치제어식으로서 최대 회전수가 1,000RPM 이상의 것 2. PLC 또는 수치제어방식의 것으로서 유리의 광택연마용으로 면조도 1um 이내의 것 3. 수치제어, PLC 또는 컴퓨터 방식의 것으로서 광디스크 제조용으로 연마가 가능한 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	43	8475-20-0000 8479-80-0000	유리원판 재생장치 (Glass Recycling System)	PLC, 수치제어식 또는 컴퓨터제어방식의 것으로서 광디스크를 원판으로 재생시키는 기능을 갖춘 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	44	8479-80-8000 8479-80-9000	감광액도포시스템 (Photo Resist Preparation System)	In-Line 방식의 것으로서 유리원판을 세척, 액칭, 건조, 감광액도포, 경화기능의 단위기기가 System화 되어 있는 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	45	8479-80-9000 9013-20-0000	디스크원판제작기 (Master Code Cutter)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. Laser를 이용한 기기로서 광디스크에 신호를 기록하여 제작하는 것으로 광원이 10mw 이상이고 Laser 파장이 500um 이하의 것 2. 디스크회전계의 최대회전수가 600Rpm 이상이고 회전정도가 10 이하의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	46	8455 8479-80-9000 9010-10-0000	현상기 (Developing M/C)	PLC, 수치제어식 또는 컴퓨터제어방식의 것으로서 레이저의 현상감시장치가 부착된 것으로 습수를 사용하는 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	47	8479-80-9000	도전막형성장치 (Metalizing System)	PLC, 수치제어식 또는 컴퓨터제어방식의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 10um 이하의 박막형성이 가능한 것 2. 무전해도금에 의한 박막형성이 가능한 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	

회사명	연번	HS세번 (10단위)	품명	규격	자동화유형	신청업체 (기관)	비고
	48	8479-81-2000 8479-89-9099	전주장치 (Stamper Masking System)	PLC, 수치제어식 또는 컴퓨터제어방식의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 니켈 도포용으로서 디스크 직경이 120mm 이상의 것 2. 정류기의 용량이 50A 이상의 것 3. Stamper의 이형성을 용이하게 하기 위한 표면처리장치를 갖춘것으로서 배기량이 1.5M/MIN 이상의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	49	9031-80-9090	디스크마스타 검사장비 (Master Playing Inspect System)	PLC, 수치제어식 또는 컴퓨터 제어방식으로 광학계의 Laser 파장이 800mm 이하의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	50	8422-40-1000 8422-40-9000	자동 포장기 (Auto Wrapping M/C)	PLC, 수치제어식 또는 컴퓨터 제어방식으로 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. Jewel.Box의 메가진용량이 450장 이상의 것 2. Over Wrapping Case 포장 능력이 1매/Sec 이상의 것	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
	51	9031-80-9090	미세두께측정기 (Ellipsometer)	수치제어방식의 것으로서 두께측정이 0.2um 이하의 것에 한함	2-가	삼성전자(주) 가전부문	
로움코리아	52	8422-40-9000	자동 포장기 (Anno Packing M/C For Axial-Taped Components)	일반 기계방식의 저항기 제조용으로 적정량 유무 감지기능 및 이탈유도 장치가 부착된 것	2-가	로움코리아	Automatic
	53	8479-89-9099	테이핑 머신 (Radial Type Taping M/C)	저항기의 자동이송을 통한 열 압착 방식의 것으로서 100PCS-130PCS/MIN의 것	2-가	로움코리아	추 가
	54	8515-29-1000	접용접기 (Automatic Welding M/C)	일반적인 자동 용접기로서 Condenser 방식의 Free Welder (1차: 전압발생, 2차: 용접)이며 300-350PCS/MIN의 것	2-가	로움코리아	추 가
	55	8456-10-0000	레이저 방식에 의한 가공 공작기계	마이크로 프로세서에 의한 방식으로 360PCS/MIN의 속도로 탄소피막 저항기 가공기계의 것	2-가	로움코리아	추 가
삼성전자 (반도체)	56	8422-40-9000	자동포장기 (Auto Tape & Reel M/C) (Auto Packing M/C)	반도체 소자포장용으로 포장속도가 600 UPH 이상의 것	2-나	삼성전자 반도체	규격추가
	57	8428-10-0000 20-2000 33-1000 33-1020 39-0000 90-0000	자동이송 (격치, 하류, 연결 또는 투입을 포함한) 장치 (Auto Transfer System)	반도체소자 제조용의 컴퓨터 제어방식으로 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 각 제조공정간 자동제어 및 일관공정 제어가 가능한 것 2. Rail 및 Conveyer 방식의 것 3. 수평 또는 수직이송(이동)이 가능한 것 4. 반도체 제조용원료 및 반제품자동 이송용의 것 5. 무인 자동운반 장치의 것 (반자동을 포함함) 6. 친구의 이체, 운송 또는 수직 적체용의 것	1-나 2-가	삼성전자 반도체	세번추가, 품목 규격추가
	58	8428-90 8479-89	자동부품 삽입기 (집장착기 Destacker, Loader, 접합기 또는 이탈기를 포함함)	PLC방식의 것으로서 P, C, B에 전자부품을 자동 삽입시키는 것	2-가	삼성전자 반도체	품목변경, 규격추가

회사명	연번	HS세번 (10단위)	품명	규격	자동화유형	신청업체 (7기 관)	비고
			(Pick & Place M/C)	마이크로 프로세서가 내장된 것			
	59	8443- 8456-10-0000 8479-89-9099	인쇄기(Marking M/C) (Laser Marking M/C)	반도체소자 제조용의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. Laser를 이용한 것 2. 유압식 또는 스크린 인쇄방식의 것 3. 분당 회전속도가 15회전 이상의 것	2-가 2-나	삼성전자 반도체	세번추가, 규격추가 &
	60	8471-	컴퓨터 (Computer)	제조공정 조정 또는 공정데이터 분석용 프로그램이 수록된 소프트웨어를 처리할 수 있는 것에 한함	1-가	삼성전자 반도체	규격추가
	61	8462-92 91 99 8479-89	자동프레스 (Auto Press M/C)	수치제어식의 것으로서 가압력 100톤 이상의 것에 한함	2-가	삼성전자 반도체	신규
	62	8471-99	산업용 컴퓨터 (Computer)	반도체 장비자동 및 프로그램 작성용의 것에 한함	1-가	삼성전자 반도체	신규
	63	8471-99 8537-10	프로그래머 (Programmer)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 수치제어식 및 컴퓨터제어에 사용되는 프로그램을 작성하기 위한 것 2. 메모리소자의 프로그램 작성 및 수록기능을 갖춘 것	1-가	삼성전자 반도체	신규
	64	8479-89-9099	부품 자동선별기 (Handler)	반도체 소자의 양, 불량품 자동 분류용의 것 성능 시험기와 연결하여 사용할 수 있는 것	2-가	삼성전자 반도체	규격추가
	66	8479-89-9099 9031-80-9000	자동리드 선별기 (교정기를 포함함) (Auto Lead Inspection System)	반도체 소자 제조용의 것으로 리드의 검사 선별 또는 교정용의 것에 한함	2-가	삼성전자 반도체	신규
	67	8479-89	테이핑기 (테이프제거기를 포함함) (Taping M/C) (Tape Removing M/C)	반도체소자 제조용의 것에 한함	2-나	삼성전자 반도체	신규
	68	8479-89	조립기 (Assembly M/C)	전자부품 조립 및 열 또는 전기접합이 가능한 것	2-가	삼성전자 반도체	신규추가
	70	8514-90	보트로더 (Boat Loader)	웨이퍼 열처리 이송요의 것에 한함	2-가	삼성전자 반도체	신규
	71	8515-11 19	자동 납땜기 (Auto Solder Welder)	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 마이크로 프로세서가 내장된 것 2. 1 Point 자동납땜이 가능한 것 3. Reflow 또는 Brazing 방식의 것 4. 컴퓨터 제어방식의 것으로서 기판의 예열 온도를 자동으로 확인 및 조정할 수 있는 것	2-가	삼성전자 반도체	신규
	72	8515-21-9099 8515-29-9000 8515-80-9000	자동와이어 접착기 (Auto Wire Bonder)	반도체 소자 제조용의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 초음파 방식의 것 2. 용접속도가 초당 2와이어(Wire/Sec) 이상의 것	2-가	삼성전자 반도체	신규
	74	9013-80	자동초점 조정장치 (Auto Focus Controller)	노광기의 것에 한함	2-가	삼성전자 반도체	신규
	75	9017-10-0000	자동 재도기	다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함	1-가	삼성전자	규격추가

회사명	연번	HS세번 (10단위)	품명	규격	자동화유형	신장업체 (기관)	비고
		20-9000	(Computer Aided Design System)	1. 컴퓨터 또는 프로그램 제어방식의 것 2. IC 및 PCB의 Artwork용의 것 3. 사용자 주문 IC 설계용의 것 4. 설치도면 작성용의 것		반도체	
	76	9030-39-9000 81-0000 89-0000	제품 성능 시험기 (Auto Test System)	반도체소자 제조용의 것으로서 부품의 전기적 특성을 측정 또는 분석하는 것으로서 프로그램 제어 방식의 것에 한함	2-가	삼성전자 반도체	신규
	77	9031-30	자동 스캐너 (Auto Scanner)	반도체 웨이퍼 가공용의 것에 한함	2-가	삼성전자 반도체	신규
	78	9031-80-9000	반도체 제조공정 종합 집중 감시장치 (Central Monitoring System)	반도체소자 제조용의 것으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 컴퓨터 제어방식의 것 2. 공정, 환경, HVAC 감시용의 것	1-나	삼성전자 반도체	신규
삼성항공 산업	79	9039-39-9000 9030-81-0000 9030-89-0000	인쇄회로기판시험기 (UB Incircuit Testing M/C)	컴퓨터 제어방식의 것으로서 측정 Point가 최대 1,024 Pin 이상의 것에 한함	2-가	삼성항공 산업(주)	
	80	8479-89-9099 8515-29-9000	자동다이 접착기 (Auto Die Ponder)	반도체 제조용으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것에 한함 1. 에폭시(Epoxy) 또는 유메틱(Eutectic) 방식의 것 2. 와이어 본더 겸용의 것 3. 접착속도 0.6 Sec/Die 이상의 것	2-가 2-가	삼성항공 산업(주)	
	81	8537-10 20	배전반 또는 제어반 (조절반을 포함함) (Auto Controller)	원격조정이 가능한 자동제어반으로서 33대 이상의 컴퓨터와 연계사용이 가능하고 일괄 공정제어가 가능한 것에 한함	2-가	삼성항공 산업(주)	
신도리코	82	8422-30-1000	토너 자동충전 설비 (Auto Toner Filling System)	자동토너 충전설비로서, 여러가지 모양의 용기(카트리지)에 입도 5-15 Micron을 600-300g씩 연속공정으로 충전시켜 Capping하는 설비로서 추진속도가 6-12분/Min일 것	2-가	(주)신도리코	